附件1

可开放共享的大型设备设施分类表

|  |
| --- |
| **1.电子信息类设备设施** |
| 1.1半导体生产线（6英寸以上，生产集成电路、半导体器件） |
| 1.2新型平板显示器件生产线（LCD、PDP、OLED、激光等） |
| 1.3新型半导体材料制成设备设施（碳化硅、砷化镓、氮化镓等材料的制成设备设施） |
| 1.4 其他电子信息类大型设备设施 |
| **2.基础制造类设备设施** |
| 2.1清洁高效高压铸造设备（40MN以上，电渣熔铸设备、真空压铸设备、大型真空冶炼及真空浇铸设备等） |
| 2.2快速成型设备（3D打印机、无模造型/芯） |
| 2.3重型锻造与挤压设备（模锻设备，10000吨以上；自由锻设备，10000吨以上；等温锻设备，8000吨以上；多向模锻设备，10000吨以上；挤压设备，8000吨以上） |
| 2.4大型辗环设备（Φ3m以上） |
| 2.5重大强力旋压设备（60吨/Φ2m以上） |
| 2.6大型板材压力机（10000吨以上） |
| 2.7新型焊接设备与自动化生产设备（大功率电子束焊接设备、大功率激光切割及焊接设备、全数字化焊接生产线、大型真空钎焊设备、3米以上超大厚度热切割设备、精密微链接设备等） |